

证券代码：300474

证券简称：景嘉微

公告编号：2025-058

长沙景嘉微电子股份有限公司

关于控股子公司边端侧 AI SoC 芯片

研发进展情况的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

长沙景嘉微电子股份有限公司（以下简称“公司”）控股子公司无锡诚恒微电子有限公司（以下简称“诚恒微”）自主研发的边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列，目前已顺利完成流片、封装、回片及点亮等关键阶段工作。芯片点亮后，经测试，其基本功能与核心性能指标（包括算力效率、模块协同及稳定性等）均已达到设计要求，标志着该项目取得阶段性突破。后续，诚恒微将加快推进芯片的功耗优化与全面性能测试，确保产品早日具备量产条件。

该芯片尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

一、边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列基本情况

诚恒微把握人工智能产业创新发展机遇，锚定边端侧算力引擎，专注提供高端主控智算处理器与高能效智能感知平台，推动智能机器从“功能执行”向“自主进化”跃升。诚恒微的业务涵盖了集成电路设计前沿研发、芯片架构设计、配套软件开发及行业解决方案赋能，构建从技术探索到产业落地的全链条能力。

诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列，基于自主研发架构，采用高集成度

的单芯片设计，集成了高端 CPU、GPU、NPU、GPGPU、ISP 等高规格处理单元，面向算力需求较高的具身智能与边缘计算等通用市场，可以涵盖包括但不限于机器人、AI 盒子、智能终端、智能识别、无人机吊舱等多种场景。芯片核心性能情况如下：

1、充沛的 AI 算力：芯片提供 64TOPS@INT8 的峰值 AI 算力，为复杂的视觉识别、多模态感知与决策模型在端侧实时运行中提供计算动力。

2、灵活计算精度：支持混合（多）精度计算，在保证推理效率的同时，兼顾了算法开发的灵活性与模型精度。

3、高实时与低延迟：具备较强的实时控制能力与较低的任务处理延迟，能够实现快速、精准的决策与执行。

4、高效多传感处理：芯片架构专为多传感器融合场景优化，能够高效协同处理来自视觉、雷达等多种传感器的数据，并构建统一的实时环境感知能力。

二、边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列对公司的影响

为积极响应国家推动高水平科技自立自强和自主可控的战略号召，公司和诚恒微正大力推动核心技术的自主研发与产业化落地，集中优势资源，充分发挥协同效应，拓宽产品应用场景并拓展服务客户领域，持续优化以“GPU+边端侧 AI SoC 芯片”为核心的产品矩阵，提升在智能算力领域的核心竞争力与市场影响力。通过不断推进芯片迭代优化和生态体系建设，加快在具身智能、边缘计算等前沿场景的实际应用，助力构建安全可控的国产化算力底座。

诚恒微 AI SoC 芯片 CH37 系列的阶段性突破，将进一步丰富公司及诚恒微产品线和核心技术储备，有利于增强公司核心竞争力，巩固公司在相关领域的市场竞争力与市场占有率，对公司长期发展战略的实施具有推动意义。

三、风险提示

诚恒微边端侧 AI SoC 芯片 CH37 系列是超大规模的集成电路产品，其功能、性能测试极为复杂。诚恒微 AI SoC 芯片 CH37 系列已完成流片、封装、回片、点亮等关键阶段工作，芯片点亮后，经测试，其基本功能与核心性能指标（包括算力效率、模块协同及稳定性等）均已达到设计要求。公司将积极关注诚恒微后续的功耗优化与全面性能测试，不排除在后续的测试、性能调试中存在不及预期

的可能性。此外，该芯片尚未形成量产和对外销售，不会对公司当期业绩产生重大影响，对公司未来业绩影响程度尚无法准确预测。同时，未来的市场需求、市场拓展及竞争情况存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

长沙景嘉微电子股份有限公司董事会

2025 年 12 月 15 日